

har-modular H3-module male angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	02 51 903 1301
Beschreibung	har-modular H3-module male angled
HARTING eCatalogue	https://harting.com/02519031301

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-modular®
Bezeichnung	H3 Modul
Komponente	Messerleiste
Kontaktbeschreibung	gewinkelt

Ausführung

Modulbreite	20,32 mm
Anschlussart	Reflowlötanschluss (THR) Wellenlötanschluss
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl	3
voreilender Kontakt auf Position	2
Länge der Pins	2,8 mm

Technische Kennwerte

Raster, steckseitig	5,08 mm
Bemessungsstrom	15 A
Luftstrecke	4 mm im Modul 4,4 mm zum Modulrand
Kriechstrecke	4,4 mm im Modul 4,6 mm zum Modulrand
Isolationswiderstand	>10 ¹¹ Ω
Durchgangswiderstand	≤8 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
Steckkraft	≤18 N
Ziehkraft	≤12 N
Anforderungsstufe	1 nach IEC 60603-2
Steckzyklen	≥500
Prüfspannung U _{eff}	2,5 kV
Isolierstoffgruppe	I (600 ≤ CTI)
Hot plugging	nein
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	schwarz
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert steckseitig Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung	F1/I2 gemäß NFF 16-101/102

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
---------------	----

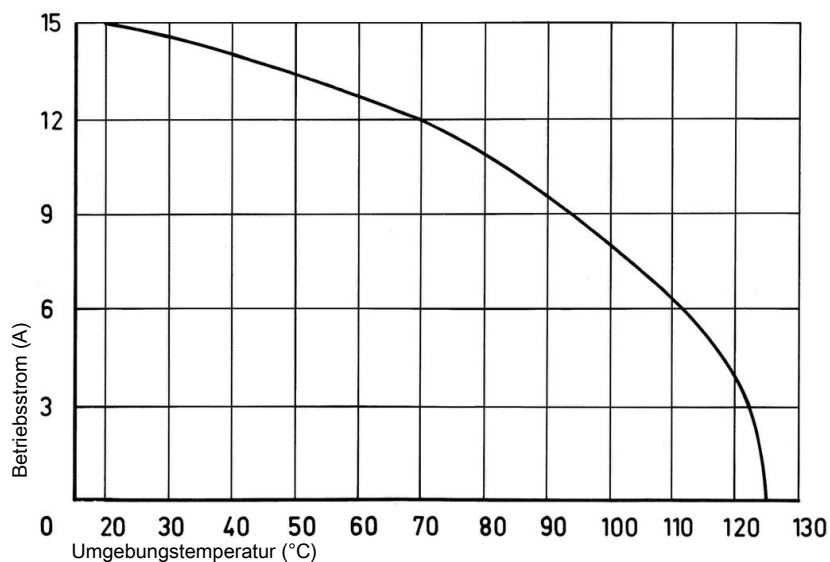
Kaufmännische Daten

Nettogewicht	0,037 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140197886
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415

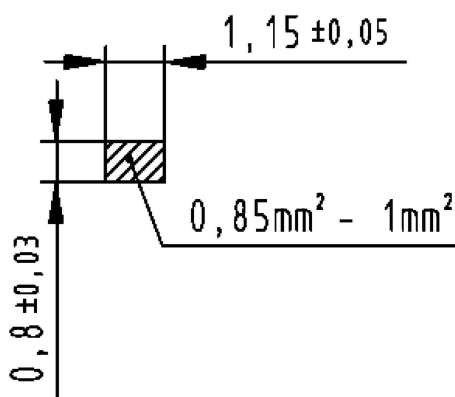
Derating Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach IEC 60512-5-2



Querschnitt des Lötanschlusses





Pushing Performance
Since 1945

Menge der Lotpaste

Vor dem Zusammenbau der Komponenten muss auf alle Löt pads (zum Verbinden von oberflächenmontierten Komponenten) und die Durchkontaktierungen Lotpaste aufgetragen werden. Um sicherzustellen, dass die durchkontaktierten Löcher vollständig gefüllt sind, muss deutlich mehr Lotpaste als bei herkömmlichen Löt pads auf die Leiterplattenoberfläche aufgetragen werden. Es stehen zahlreiche Berechnungsmethoden zur Verfügung, deren Anwendung kompliziert ist. Die folgende Faustregel hat sich in der Praxis bewährt.

Erforderliches Pastenvolumen = $2 \times (\text{Volumen der Durchkontaktierung} - \text{Volumen des Steckeranschlusses in der Bohrung})$

Bemerkung: Der Multiplikator "2" gleicht den Lotpastenschwund beim Löten aus. Zu diesem Zweck wurde angenommen, dass 50% der Paste aus dem eigentlichen Lot bestehen, die anderen 50% sind Löthilfsmittel.

Lötanleitung

THR-Steckverbinder (ThroughHoleReflow) sind für die Verwendung in einem Reflow-Ofen zusammen mit anderen SMD-Bauteilen (SurfaceMountDevice) vorgesehen. Dabei werden die Steckverbinder, auch "Pin-in-Hole-Intrusive-Reflow" genannt, in vergleichbarer Weise wie bei der konventionellen Bauteilmontage in Durchkontaktierungen eingeführt. Alle anderen Komponenten können auf der Leiterplattenoberfläche montiert werden.

Die Steckerkontakte sollten so lang sein, dass sie nach dem Einsetzen in die Leiterplatte nicht mehr als 1,5 Millimeter herausragen. Jeder Kontakt sammelt Lötzin an seiner Spitze, wenn er in das Loch eindringt. Wenn der Kontakt zu lang ist, kann dieses Lot während des Lötvorgangs nicht mehr durch Kapillarwirkung in die Durchkontaktierung zurückfließen, wodurch die Qualität der Lötverbindung beeinträchtigt wird.

Lötanleitung

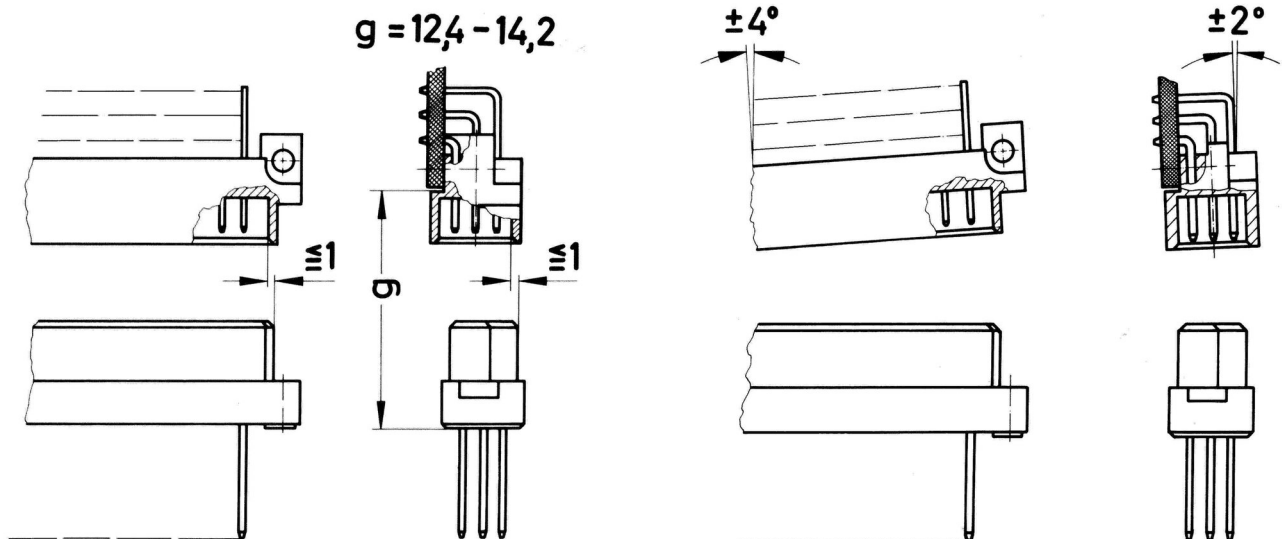
Die Steckverbinder sollten beim Löten geschützt werden. Andernfalls können sie durch Lötvorgänge verunreinigt werden oder sich durch Überhitzung verformen.

1) Bei Prototypen und Kleinserien schützen Sie die Steckverbinder mit einem Industrieklebeband, z.B. Tesaband 4331 (www.tesa.de). Decken Sie die Unterseite des Steckverbinder-Isolierkörpers und die angrenzenden Teile der Leiterplatte sowie die offenen Seiten des Steckverbinders ab. Dadurch wird verhindert, dass Hitze und Gase des Lötgeräts den Steckverbinder beschädigen. Etwa $140 + 5$ mm des Bandes sollten ausreichen.

2) Für große Serien wird ein Lötrahmen empfohlen. Sein Schutzdeckel mit einer schnell wirkenden mechanischen Verriegelung schützt die Steckverbinder vor Gas und Wärme, die vom Lötgerät erzeugt werden. Als zusätzlicher Schutz kann eine Folie zum Abdecken der nicht zu verlötenden Teile verwendet werden.

3) Für Muster- und Kleinserien kann die unter 1) beschriebene Abdeckung auch mit Hilfe eines Lötenschutzadapters vorgenommen werden. Dieser Lötenschutzadapter ist unter der Artikelnummer 09 02 000 9935 erhältlich.

Steckbedingungen



Um eine sichere Kontaktgabe zu gewährleisten und ein Beschädigen der Steckverbinder zu verhindern, sind nachfolgende Einbauhinweise zu beachten.

Diese Steckbedingungen entsprechen IEC 60603-2.

Die Steckverbinder sollen nur spannungslos betätigt werden.